



Investor Relations 2026

2025년 4분기 에이엘티 경영성과



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사에이엘티(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

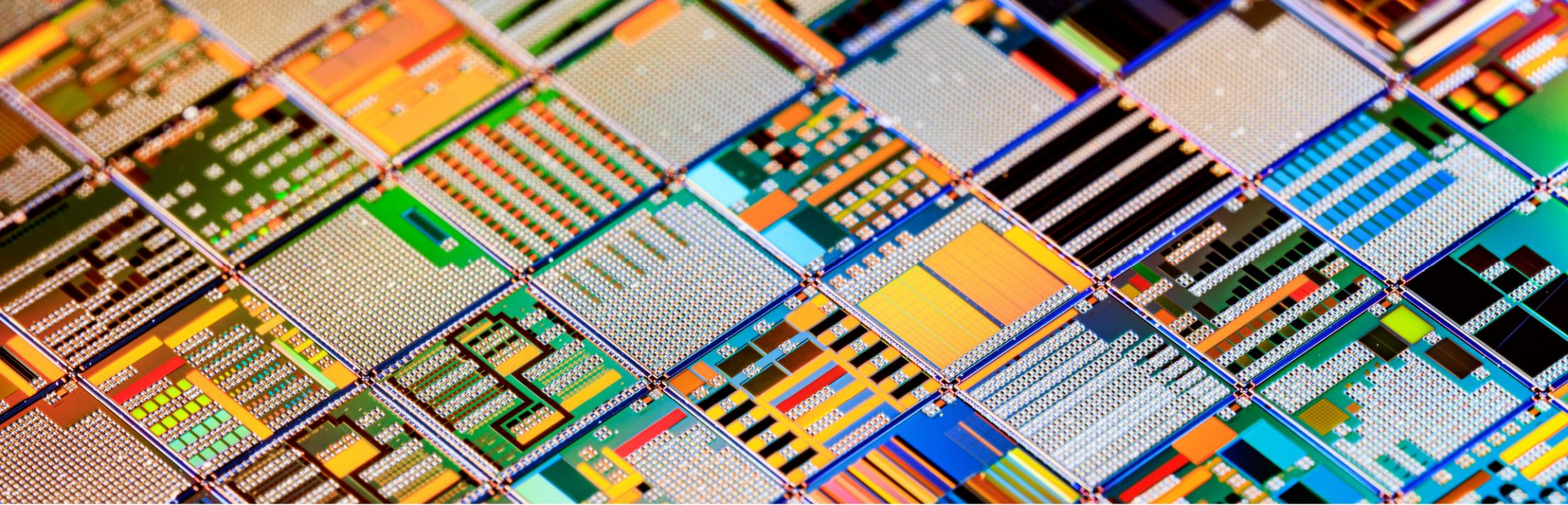
본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



ADVANCED LINK TECHNOLOGY

TABLE OF
CONTENTS

Chapter 01
COMPANY OVERVIEW

Chapter 02.
EARNING REVIEW

APPENDIX

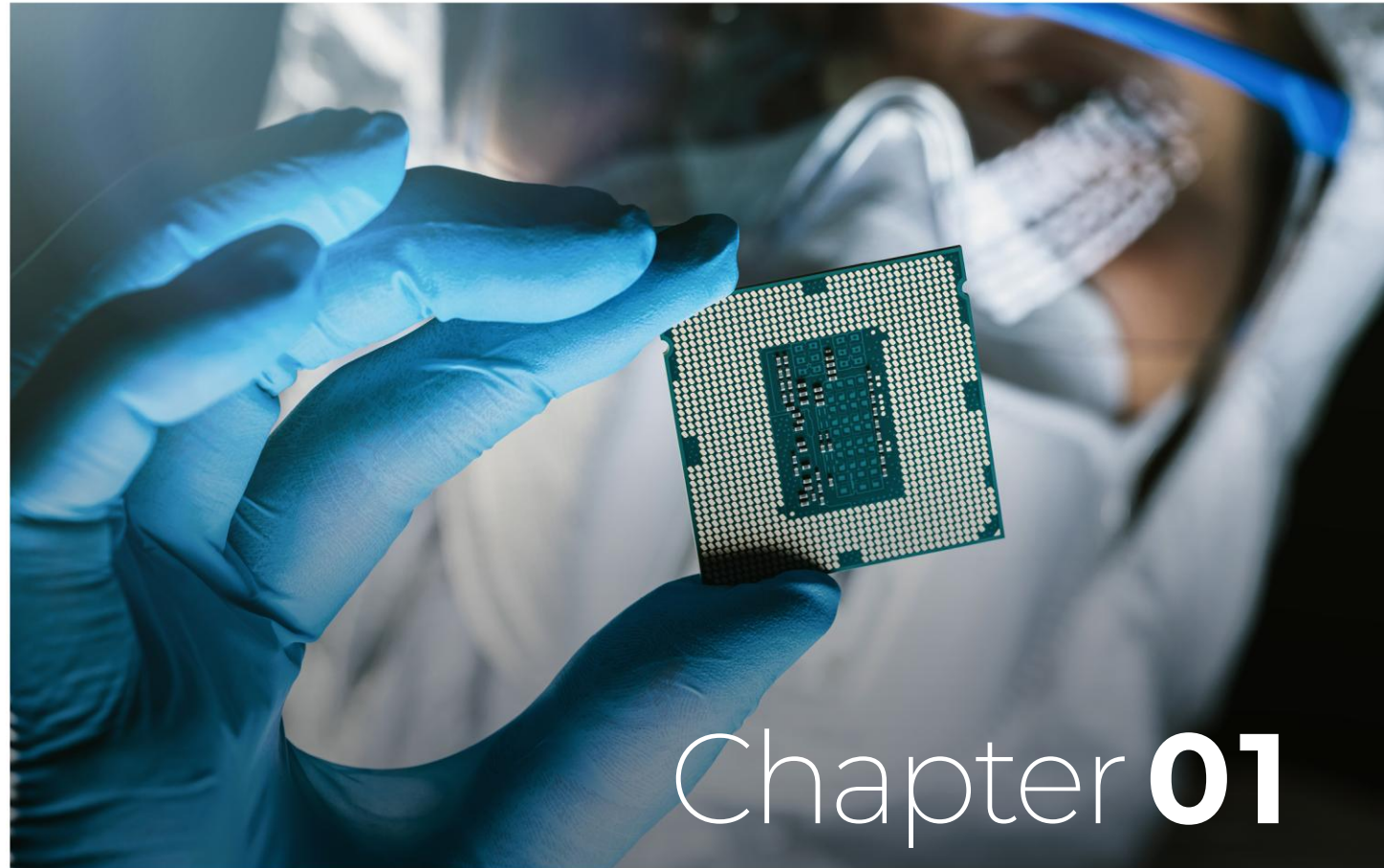


COMPANY OVERVIEW

1. ALT 비메모리 반도체 공정 영역
2. 사업영역
3. 다양한 고객사 확보
4. 신규 사업영역 확장



ADVANCED LINK TECHNOLOGY

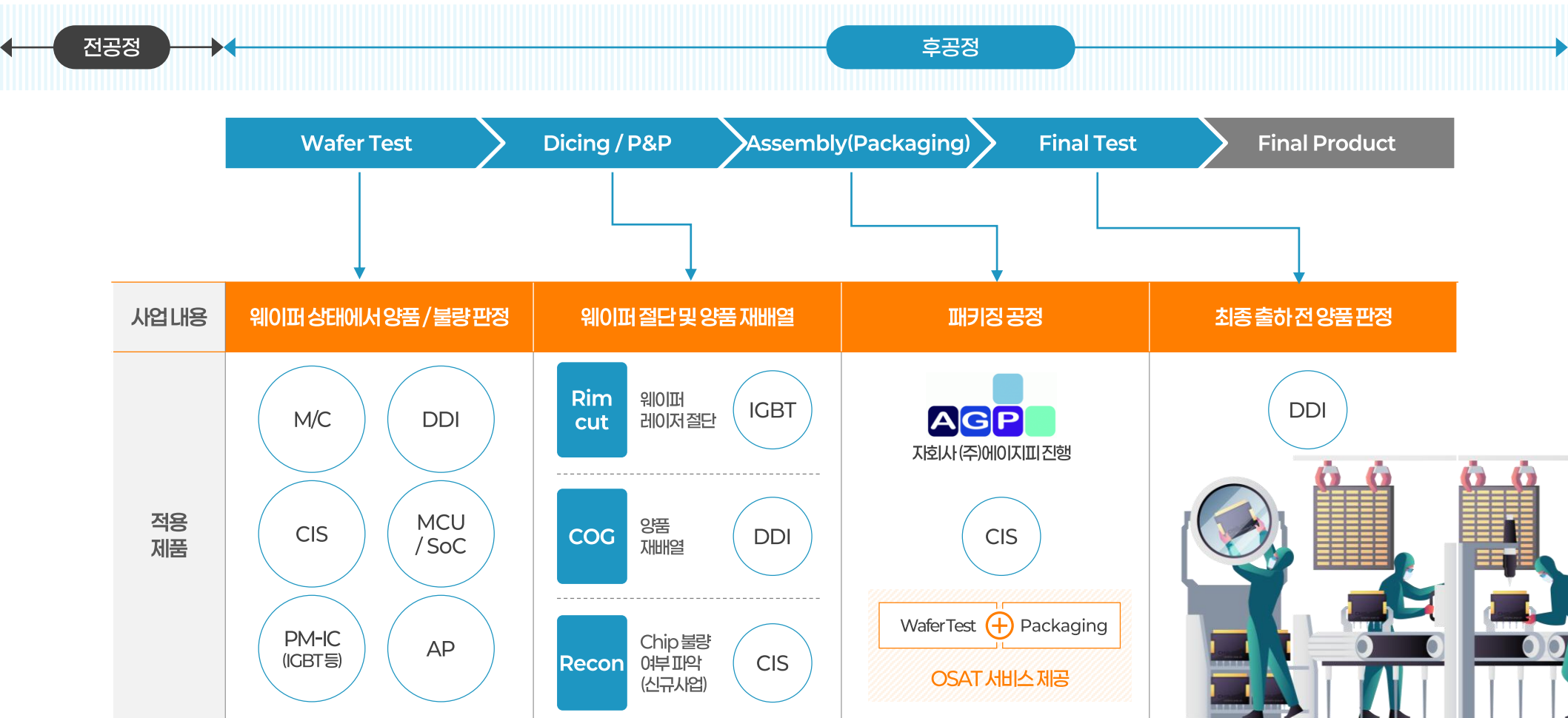


Chapter **01**

01. ALT 비메모리 반도체 공정 영역

비메모리 반도체 후공정 토탈 솔루션 제공

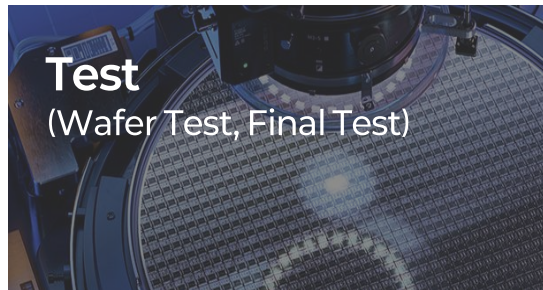
■ ALT 사업 영역



02. 사업영역

OSAT(Wafer test + Packaging) 사업 기반 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무 수행

매출분야



ALT 주요 비메모리 반도체

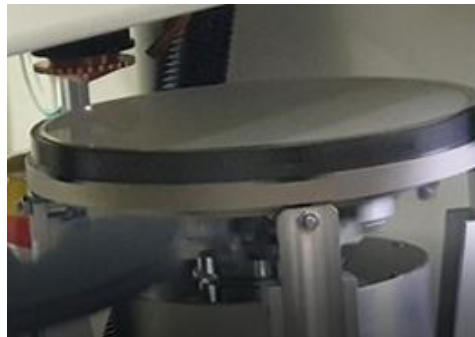
<p>M/C (Memory Controller)</p> <p>메모리를 관리, 제어하고 효율적인 데이터 처리를 지원하는 칩</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, PC, 서버, 데이터센터</p>	<p>DDI (Display Driver IC)</p> <p>각종 LCD Panel, LED, OLED 등을 구동 시키는 반도체 소자</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, TV, PC, 스마트워치</p>	<p>CIS (CMOS Image Sensor)</p> <p>빛에너지를 전기적인 신호로 변환하는 집적회로가 내장된 이미지 센서</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, CCTV, 자동차, 로봇</p>
<p>MCU/SoC</p> <p>전자기에 채택되는 통합 칩(SoC) 단순 동작부터 시 등 다양한 특성을 제어</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, IoT, 자율주행, 스마트 팩토리</p>	<p>PM-IC (IGBT 등)</p> <p>전자기에 필요한 전력 공급 및 효율적 관리</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, 노트북, 전기차, IoT</p>	<p>AP (Application Processor)</p> <p>모바일 기기와 임베디드 시스템의 다양한 작업을 처리하는 통합 프로세서</p> <p>적용 산업</p> <p>스마트폰, 스마트워치, 자동차, IoT</p>

03. 다양한 고객사 확보

ALT만의 차별화된 기술 제공으로 다양한 고객사 확보

국내 유일 Rim-Cut 솔루션 제공

Laser Cut 방식의 Taiko Wafer 절단 프로세스를 자동화된 단일 공정으로 통합, Chip 수율을 향상시키는 국내 유일 솔루션



열, 스크랩에 의한
불량 감소
수율 극대화

단일 공정을 통한
납기 단축

Recon Turn-Key 서비스 제공

Wafer Test와 함께 절단 및 분리, 양품 Chip을 성능별로 재배열하는 Turn-Key 서비스 제공



고품질
생산 시스템 구축

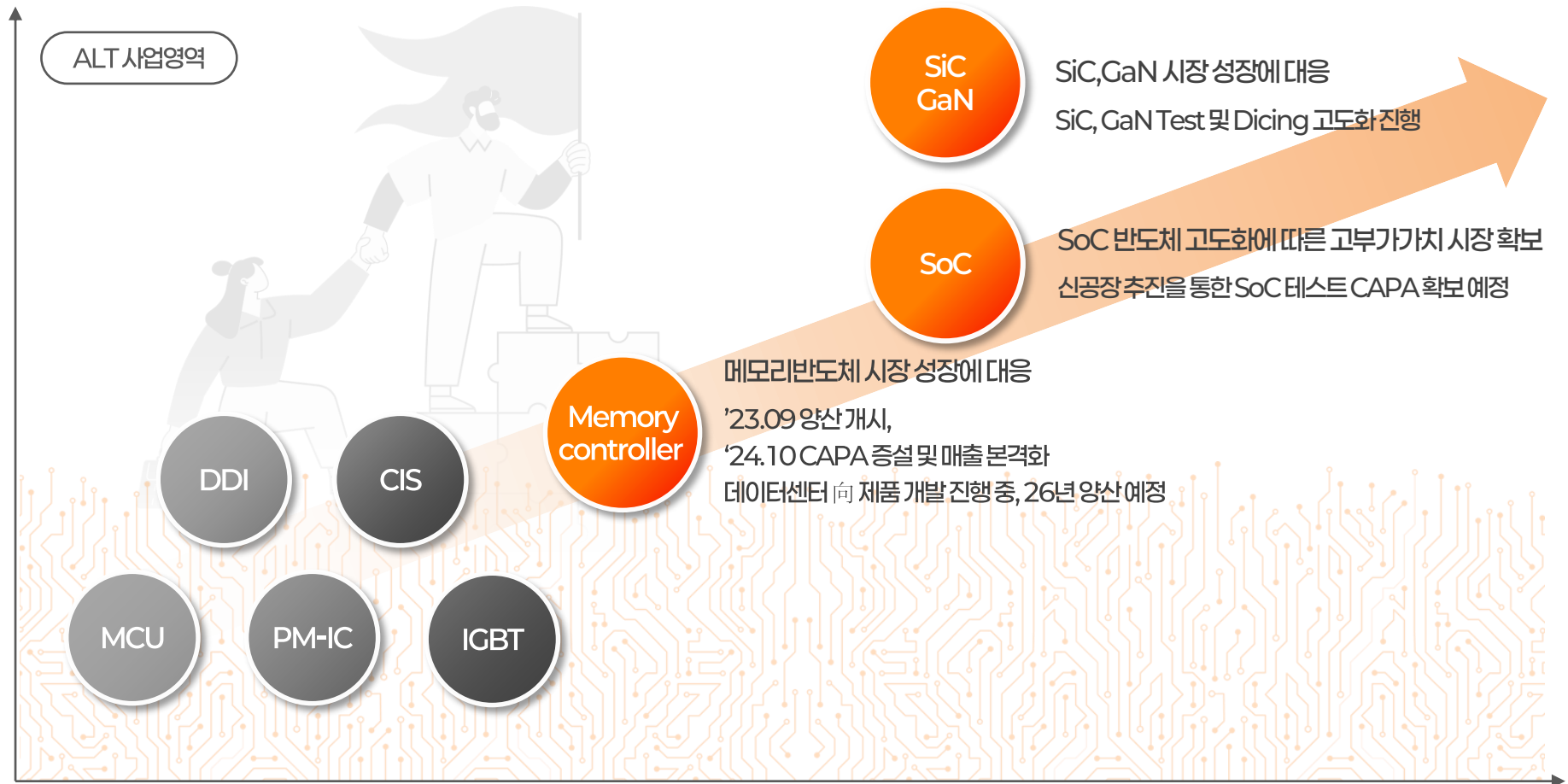
신속한 후속
공정 지원

주요 고객사 현황



04. 신규 사업영역 확장

Memory Controller, SoC 등 고부가가치 테스트 품목으로 사업영역 다변화



EARNING REVIEW

1. 2025년 4분기 경영실적
2. 2025년 4분기 사업별 매출 비중
3. 2025년 연간 실적



ADVANCED LINK TECHNOLOGY



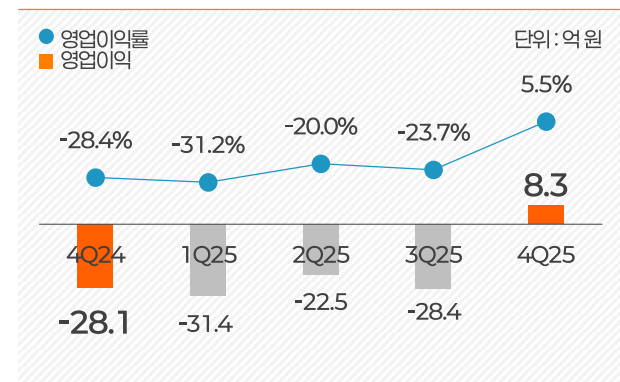
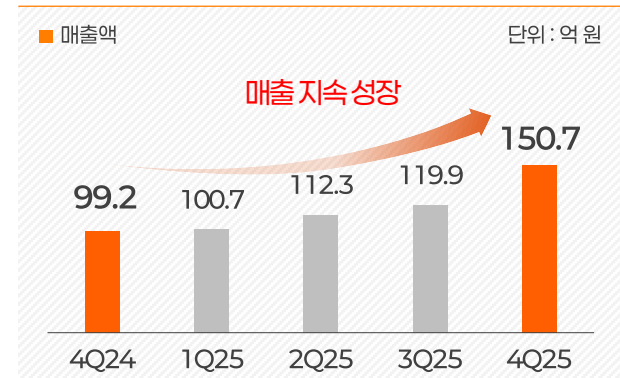
Chapter **02**

01. 2025년 4분기 경영실적 (외부감사인의 감사전 자료로 감사 후 변동 가능성 있음)

매출액 150.7억, 영업이익 +8.3억, 당기순이익 +43.4억

- » 매출액: 전년 동기 대비 큰 폭 매출 증가(+51.9%), 전분기 대비 매출 증가(+25.7%)
- » 영업이익: 전년 동기 대비 흑자 전환, 전분기 대비 흑자 전환

(단위: 억 원)	4Q24	3Q25	4Q25	YoY	QoQ
매출액	99.2	119.9	150.7	+51.9%	+25.7%
매출원가	117.5	135.8	130.0	+10.6%	-4.3%
판매비와관리비	9.8	12.5	12.4	+25.7%	-1.3%
감가상각비와 무형자산상각비*	58.8	59.7	55.7	34.2%	32.2%
영업이익	-28.1	-28.4	+8.3	흑자전환	흑자전환
(영업이익률)	-28.3%	-23.7%	+5.53%	-	-
이자비용	13.5	12.4	12.0	-11.1%	-3.2%
법인세비용	-21.9	-1.8	-20.0	-	-
당기순이익	-20.0	-37.9	43.4	흑자전환	흑자전환
(당기순이익률)	-20.2%	-31.6%	+28.8%	-	-
EBITDA**	28.9	31.2	64.0	121.5%	104.1%



주: K-IFRS 연결 기준

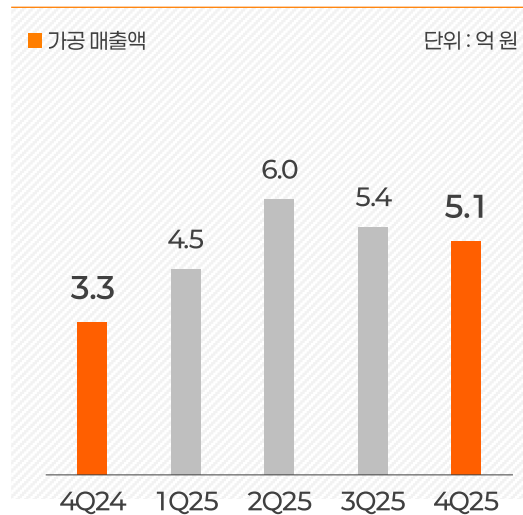
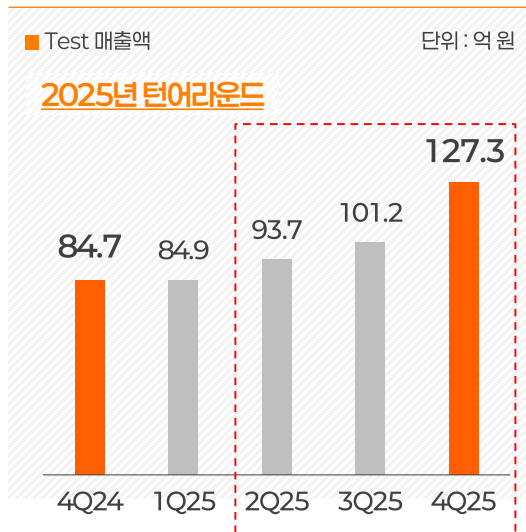
*감가상각비와 무형자산상각비는 매출원가와 판매관리비에 계상된 금액을 합산한 값임

**EBITDA=감가상각비+무형자산상각비+영업이익

02. 2025년 4분기 품목별 매출 비중 (외부감사인의 감사 전 자료로 감사 후 변동 가능성 있음)

품목별 매출 비중

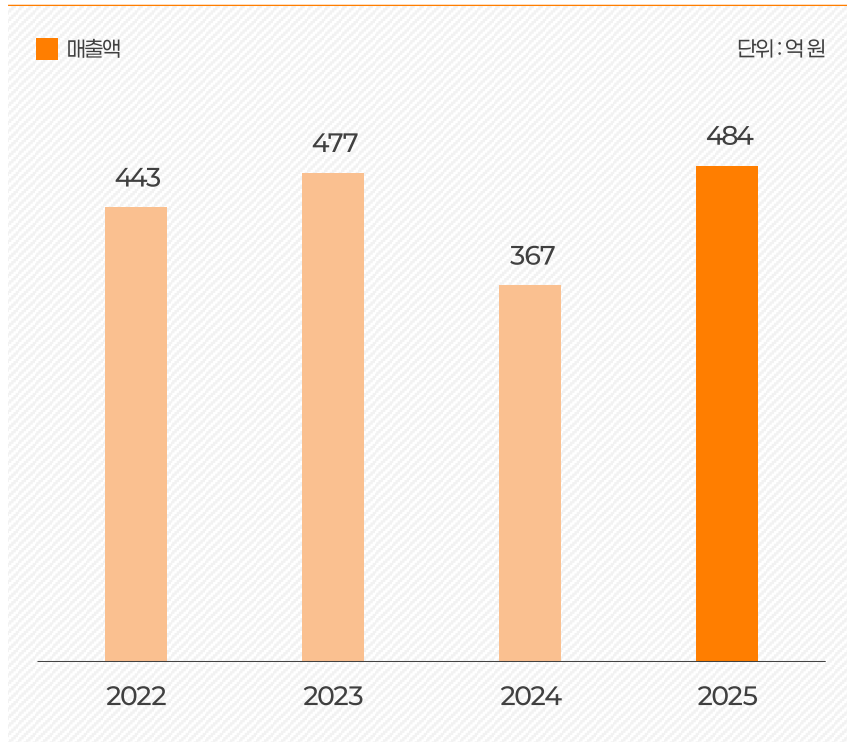
(단위: 억 원)	4Q24	3Q25	4Q25	YoY	QoQ
매출액	99.2	120.0	150.7	51.9%	+25.7%
Test 매출	84.6	101.2	127.3	50.4%	25.8%
가공 매출	3.3	5.4	5.1	52.0%	-5.8%
Packaging	11.2	13.3	18.3	62.9%	37.7%



03. 2025년 연간 실적 (외부감사인의 감사전 자료로 감사후 변동 가능성 있음)

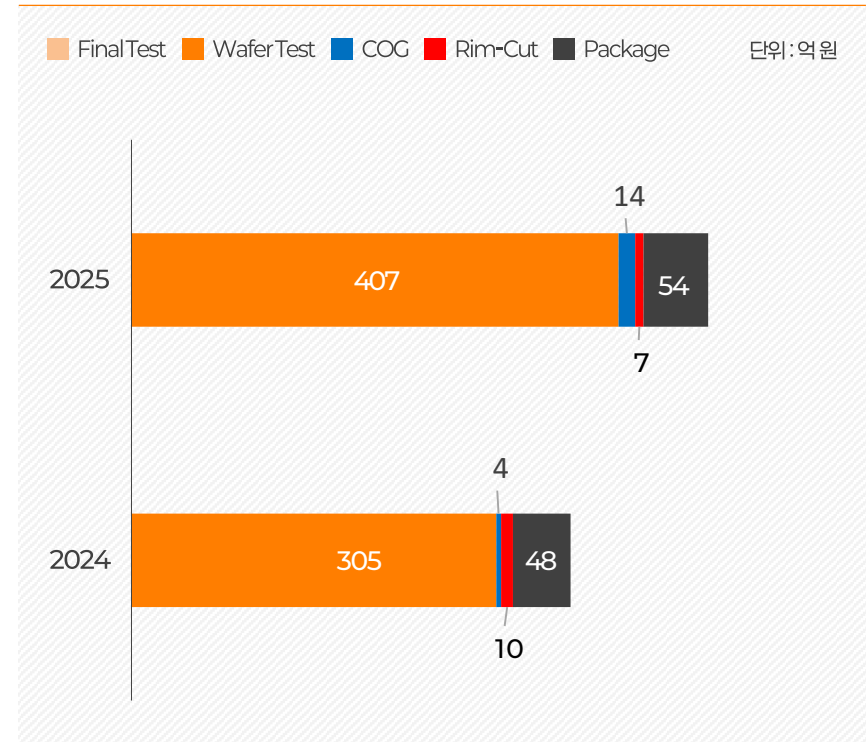
- » Test 매출 : 전년 대비 매출액 33.6% 증가(M/C 51.6% 증가, DDI 43.7% 증가, MCU외 기타 -5.4% 감소)
- » 기타 매출 : 전년 대비 매출액 51.4% 증가 (RING CUT 25.3% 감소, P&P 233.4% 증가)
- » 자회사 매출: 전년 대비 매출액 15.5% 증가

매출액



주: K-IFRS 연결 기준

전년 대비 사업부별 매출액

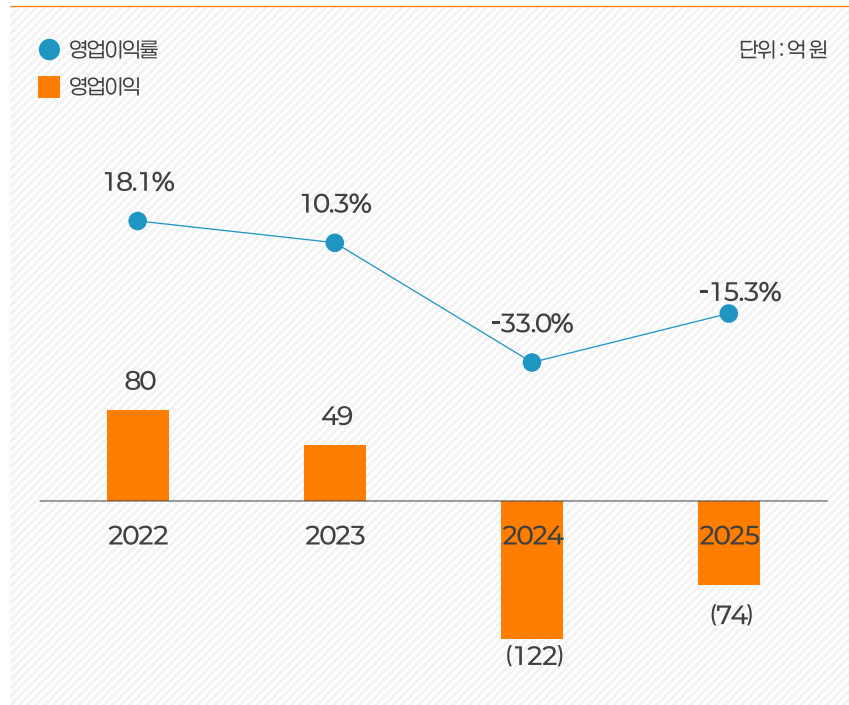


04. 2025년 연간 실적 (외부감사인의 감사 전 자료로 감사 후 변동 가능성 있음)

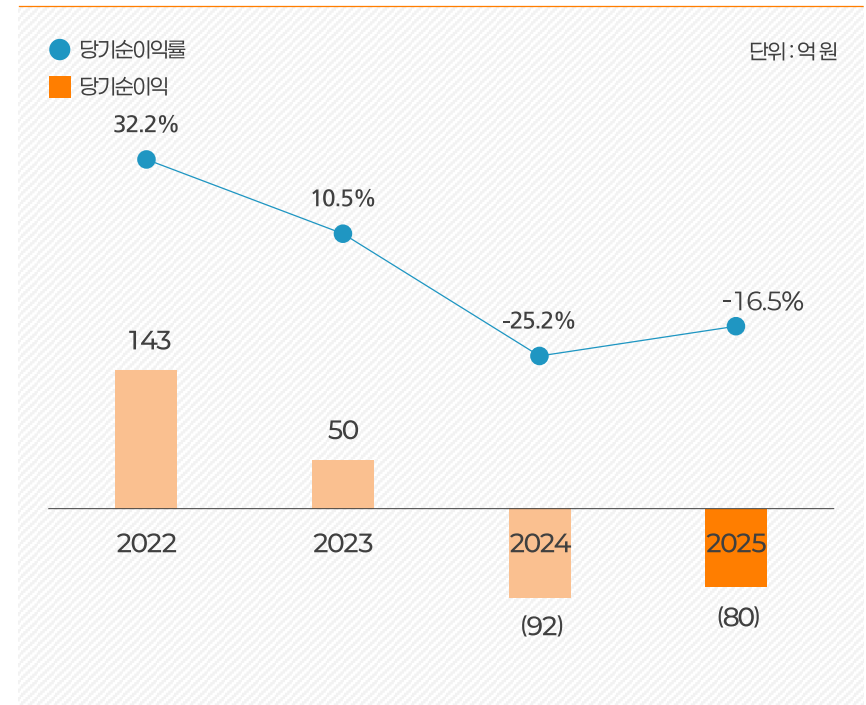
설비투자에 따른 비용 부담 지속에도 불구하고, 수익성은 2024년 대비 뚜렷한 개선

- » 영업손익 : M/C 중심 설비 증설로 감가상각비 부담은 지속되었으나, 매출 회복에 따라 영업손실 및 순손실 규모는 전년 대비 축소

영업이익(률)



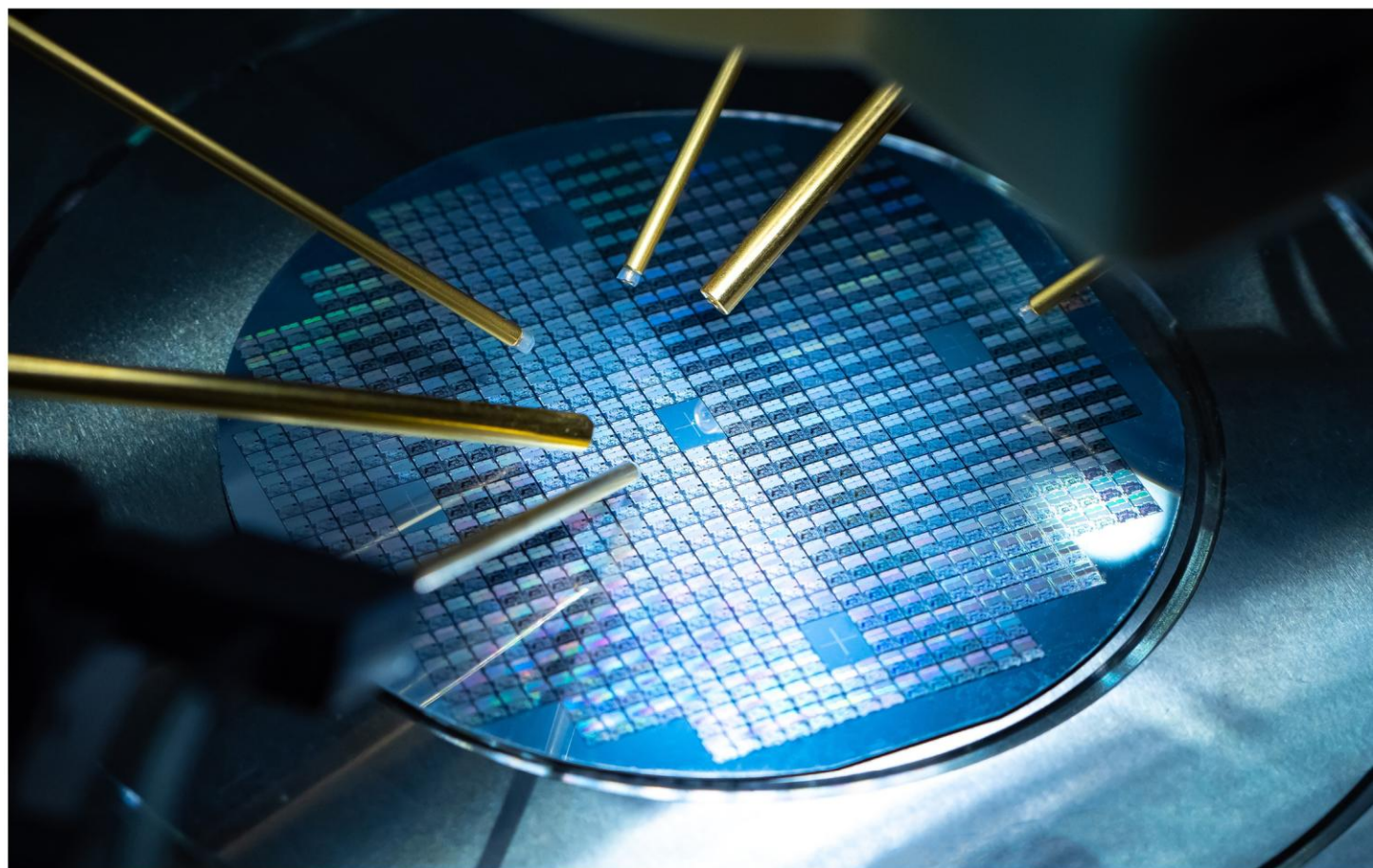
당기순이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

APPENDIX

1. 회사개요
2. 회사연혁
3. 공정 소개
4. 2025 요약 재무제표



01. 회사 개요

22년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문 기업

기업개요

회사명	(주)에이엘티
대표이사	천병태
설립일	2003년 7월 23일
자본금	44.8억 원
본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
홈페이지	www.alt-s.kr

대표이사



천병태 CEO

경력

- 한국동경실리콘연구소
- SK하이닉스반도체제조부문 상무이사
- (주)ALT 설립/전대표이사

수상내역

- 우수중소기업인 부문 충북지방중소기업청 표창
- 혁신기업경영중소기업 부문 중소기업중앙회 표창
- 모범납세자 부문 대통령 표창

지배구조 및 사업영역



02. 회사 연혁

비메모리 반도체 포트폴리오가 다변화된 OSAT 전문기업으로 성장 중



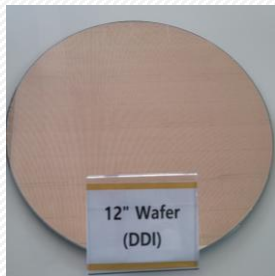
03. 공정 소개 ① Probe Test

반도체 수율 향상을 위한 필수공정



Probe Test Process

Wafer 상태의 Chip의 양품 선별공정으로, Chip의 불량 식별 및 설계상의 문제점을 발견해 개선하는 공정으로, 반도체 수율 향상을 위해 반드시 필요한 솔루션



Wafer

웨이퍼 투입

Prober에 투입, 자동검사

적용제품
M/C, DDI, CIS,
MCU/SoC, PM-IC, AP 등



TEST LINE



TESTER+PROBER

Wafer Test

Chip의 양품 / 불량 여부 및 고유값 측정



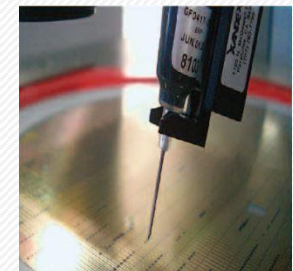
PROBER



AVI

AVI 검사

외관상 이물, 기타 특이사항
검사



INKING

잉킹

불량 칩에 잉크로 표시

03. 공정 소개 ② Ring(Rim) Cut

PM-IC(IGBT 등) 웨이퍼 테스트 및 국내 유일 Rim Cut 기술을 Turnkey로 제공



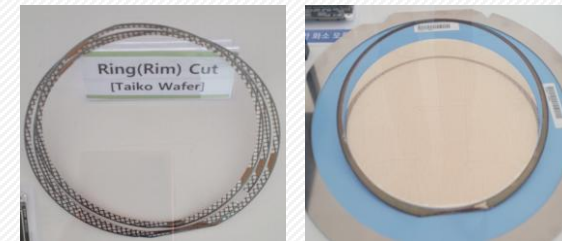
Ring(Rim) Cut Solution

국내 최초로 Laser Cut 방식을 도입, Kerf width 최소화로 Net Die 손실을 줄이는 Taiko Wafer 테두리 절단 분리 솔루션



Full Auto System

5개 공정을 1개 공정으로 단축, Handling 과정에서 발생하는 Wafer Damage 발생 근본적으로 해소



Taiko Wafer

Wafer 안쪽을 얇게(70 μ m) 갈아내고, 테두리는 두껍게 남겨놓는 가공공법



Blade Saw

절단폭이 넓어 Net Die 수량감소
파편에 의한 Chip 손상으로 수율 감소

Laser Cut

절단폭 최소화, Net Die 최대화
열손상 및 파편에 의한 Chip 손실 예방

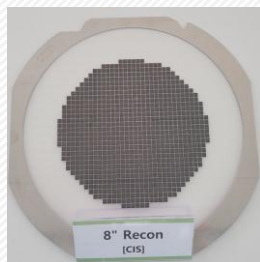
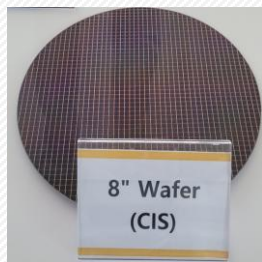
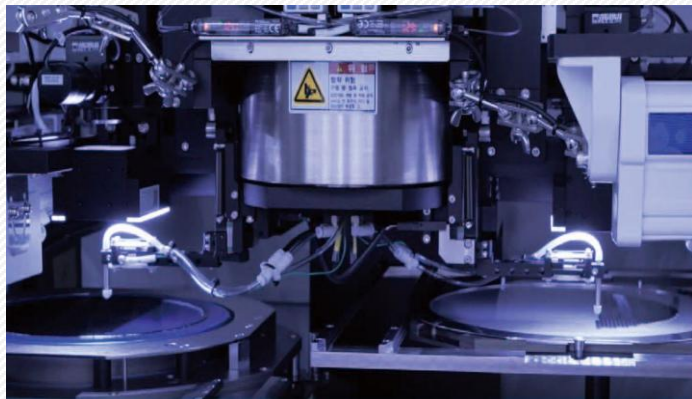
03. 공정 소개 ③ Recon(CIS 등)

양품 체크 및 성능별 칩 재배열 기술을 Turnkey로 제공해 사업 확장 실현



Recon : Wafer Reconstruction

Sawing 후 양품 Chip을 Pick Up하여 고객 요청에 맞추어 Wafer 형태로 테이프에 재배치하는 솔루션



COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배열



- 양품 chip
- 불량 chip

Wafer 사이즈별 재배열

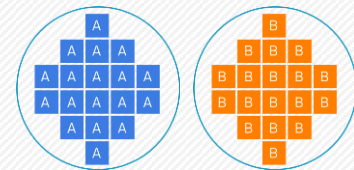
8인치, 12인치 웨이퍼,
*경박단소 필요제품 재배열 가능

고품질 생산 시스템 구축

Turnkey 서비스 제공
생산 표준화 MES 시스템 구축

Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배열



성능별 Chip 재배열

빠른 후속 공정 가능

One Stop 솔루션 제공

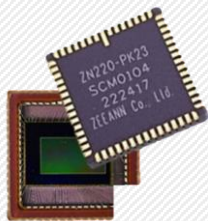
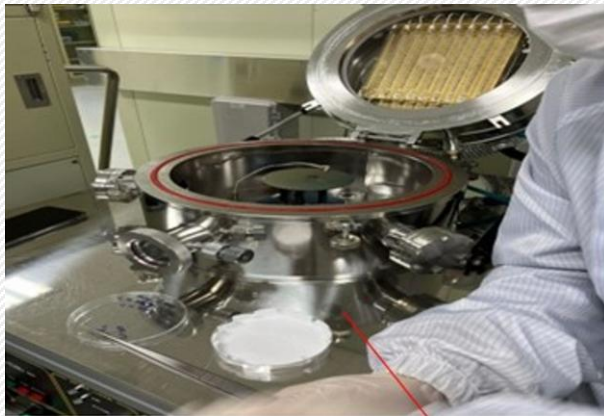
Test - Back Grinding
- Sawing - Recon

03. 공정 소개 ④ Package

CLCC(고신뢰성 세라믹 패키지), PLCC(플라스틱 패키지) 조립 및 테스트 공정



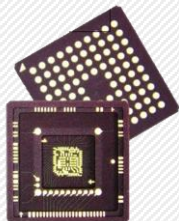
Automotive & Military Sensor



CLCC
일반용

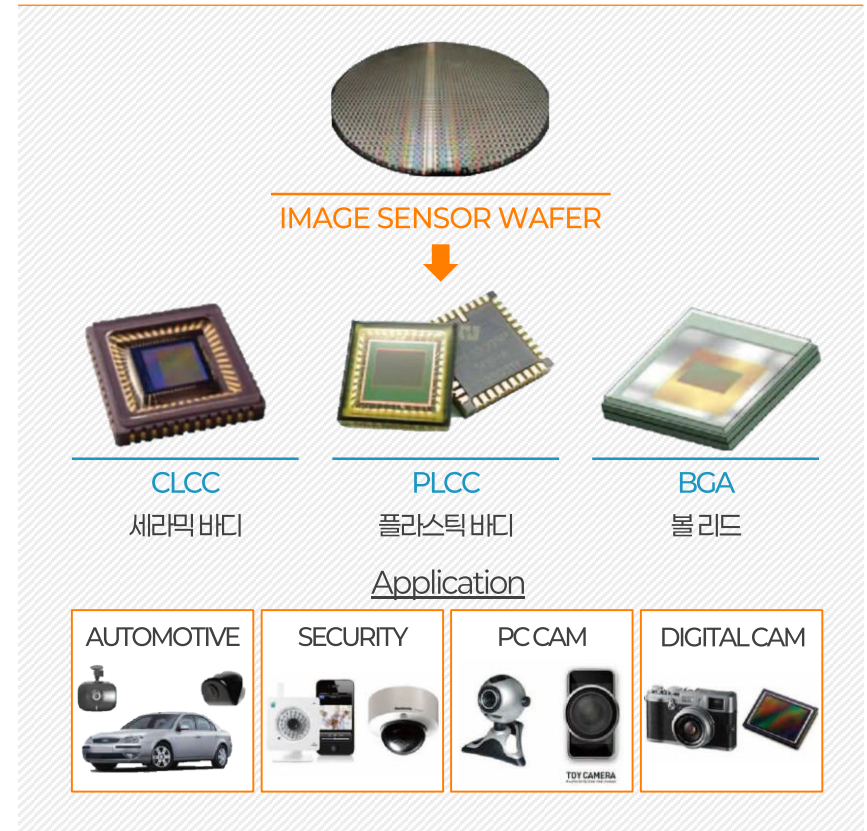


A_BGA
전장 및 방산용



MCP
멀티칩

CIS



04. 요약 재무제표 (외부감사인의 감사전 자료로 감사 후 변동 가능성 있음)

재무상태표

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025
유동자산	13,508	21,743	16,867	28,500
비유동자산	170,372	176,290	200,792	177,214
자산총계	183,880	198,033	217,659	205,712
유동부채	62,708	31,718	35,494	53,510
비유동부채	51,819	58,634	79,829	58,396
부채총계	114,527	90,352	115,323	111,906
자본금	3,781	4,480	4,480	4,480
자본잉여금	24,459	57,822	64,608	64,608
자본조정	(984)	(984)	(2,976)	(2,976)
기타포괄손익 누계액	6,425	4,892	4,556	3,732
이익잉여금	34,922	40,892	31,051	23,244
자본총계	69,353	107,681	102,336	93,806

K-IFRS 연결 기준

손익계산서

단위: 백만원

구분	2022	2023	2024	2025
매출액	44,319	47,688	36,667	48,358
매출원가	31,969	37,498	44,275	50,842
매출총이익	12,350	10,190	(7,608)	(2,484)
판매관리비	4,324	5,294	4,600	4,911
영업이익	8,026	4,895	(12,208)	(7,395)
금융수익	3,383	812	913	(5,725)
금융비용	2,846	8,068	7,149	6,093
기타수익	2,221	3,609	1,765	9,143
기타비용	-	1,576	-	6,756
법인세비용차감전 순이익	10,784	(329)	(16,691)	(10,734)
법인세비용	(3,476)	(5,351)	(7,447)	(2,767)
당기순이익	14,260	5,023	(9,282)	(7,967)